

— お詫びと訂正 —

学会誌掲載記事正誤表

日本銅学会誌「銅と銅合金」に掲載されました以下の論文で、一部内容に誤りがありました。
会員の皆様に謹んでお詫びいたしますとともに、下記の通り訂正いたします。

- 日本銅学会誌「銅と銅合金」第 64 巻 1 号(2025) p. 83-87.
「W/ODS-Cu ブレージング界面における接合拡散影響部の三次元組織解析」 嶋田 雄介 他

・ P. 83 タイトル

誤	3D Structural Analysis of Diffusion Affected Zone at W/ODS-Cu Brazing Interface
正	3D Structural Analysis of the Interfacial Reaction Zone at the W/ODS-Cu Brazing Interface

・ P. 83 Abstract

誤	Consequently, the diffusion of nickel atoms, the raw material of the brazing material, obtained two characteristic microstructures: first, in the nickel atoms diffusion region, nickel was solidly dissolved by copper and enhanced the grain growth of copper while remaining in a dispersed oxide distribution. In the other, nickel formed an intermetallic compound NiW ₂ with tungsten and was distributed to cover the bonding interface.
正	Consequently, a near-interface region affected by Ni diffusion from BNi-6 and possible local melting/reaction during brazing, hereafter referred to as the interfacial reaction zone, was formed and exhibited two characteristic microstructural features. First, in the Ni-enriched Cu region, Ni was dissolved in the Cu matrix and promoted Cu grain growth while maintaining the dispersion of oxide particles. Second, Ni reacted with W to form the intermetallic compound NiW ₂ , which was distributed along the bonding interface.

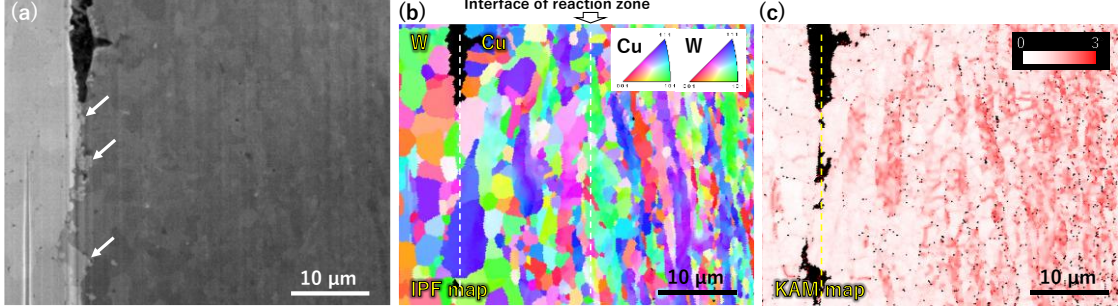
・ P. 84 2.2 6 行目

誤	10 keV
正	10 kV

・ P. 84 2.2 18 行目

誤	200 keV
正	200 kV

- P. 84 Fig. 1 (a)

誤	arrowhead 欠落 (b)Interface of diffusion affected zone
正	arrowhead 追加 (b)Interface of reaction zone 

- P. 84 Fig. 1 キャプション

誤	A SEM secondary electron image (a), an IPF map (b) and KAM map showing local strain (c) obtained by EBSD of the diffusion affected area of the bonding.
正	A SEM secondary electron image (a), an IPF map (b) and KAM map showing local strain (c) obtained by EBSD of the interfacial reaction zone of the bonding.

- P. 85 Fig. 2 キャプション

誤	A HAADF-STEM image of the diffusion affected area of the bonding. The results of phase analysis by electron diffraction and EDS from A to E in the figure are shown on the right.
正	A HAADF-STEM image of the interfacial reaction zone of the bonding. The results of phase analysis by SAED patterns and EDS from A to E in the figure are shown on the right.

- P. 85 Fig. 3 キャプション

誤	HAADF-STEM image (a) and LAADF-STEM image (b) obtained from diffusion affected area.
正	HAADF-STEM image (a) and LAADF-STEM image (b) obtained from the interfacial reaction zone .

・ P. 85 3.1 25 行目

誤	一方で、Cu 母相中にはブレージング材からの Ni 原子が固溶していることから、拡散熱影響による組織変化は Cu 母相中におけることから、熱拡散影響による組織変化は Cu 母相中におけるものが主であることが示唆される。F i g. 3 に拡散熱影響部における拡大H A A D F－S T E M像(a)と同領域における LAADF－STEM 像(b)を示す。
正	一方で、Cu 母相中にはブレージング材からの Ni 原子が固溶していることから、拡散熱影響による組織変化は Cu 母相中におけることから、熱拡散影響による組織変化は Cu 母相中におけるものが主であることが示唆される。一方で P 濃度については界面からの距離に関わらず EDS の検出限界以下であった。F i g. 3 に拡散熱影響部における拡大H A A D F－S T E M像(a)と同領域における LAADF－STEM 像(b)を示す。

・ P. 87 参考文献[7]

誤	[7] Y. Shimada, M. Kazukawa, Y. Hishinuma, K. Ikeda, H. Noto, B. Ma, M. Takeguchi, T. Muroga and T. J. Konno : Multiscale structural characterization of yttria dispersed copper alloys fabricated by hot isostatic processing of mechanically alloyed powders, Materialia 14(2020), 100892.
正	[7] M. Sato, Y. Shimada, Y. Hishinuma and N. Masahashi: Fabrication of oxide dispersion strengthened copper alloy powders by atmosphere-controlled gas atomization, Mater. Trans., 66 (2025), 1036–1042.